

출력 일자: 2004/7/23

발송번호 : 9-5-2004-029257487

수신 : 서울 중구 순화동 1-170 에이스타워 4층

발송일자 : 2004.07.22

신영무 귀하

제출기일 : 2004.09.22

100-712

특허청 의견제출통지서

출원인 명칭 한국전자통신연구원 (출원인코드: 319980077638)

주소 대전 유성구 가정동 161번지

대리인 성명 신영무

주소 서울 중구 순화동 1-170 에이스타워 4층

출원번호 10-2002-0064135

발명의 명칭 도파관 구조의 패키지 및 그 제조 방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매 회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장 승인통지는 하지 않습니다.)

[이 유]

이 출원의 특허청구범위 제1항 및 제10항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아 래]

본원발명의 특허청구범위 제1항은 도파관 구조의 패키지에 관한 것으로서 "상단 하우징; 및 RF 신호가 입출력되는 도파관 및 상기 도파관 사이에 위치되는 중앙부의 상단에 탑재된 반도체 칩을 포함하는 하단 하우징을 포함하되, 상기 반도체 칩은 상기 도파관을 통해 입출력되는 RF 신호를 전송하는 입력 스트립부 및 출력 스트립부를 포함하고, 상기 상단 하우징과 상기 하단 하우징은 서로 대응되도록 결합된 것"을 특징으로 하고 있으며, 제10항은 상기 도파관 구조의 패키지를 제조하는 방법에 관한 것입니다. 출원인이 본원발명의 상세한 설명에 기재한 종래기술과 상기 본원발명과의 차이점은, 본원발명에서는 반도체 칩에 RF 신호를 전송하는 입력 스트립부 및 출력 스트립부가 존재한다는 것이나, 이러한 본원발명과 종래기술과의 차이점은 일본공개특허공보 평6-283914호(94.10.07.자 공개, 이하 "인용발명"이라 한다)에 "경질재료의 기판(23)으로 집적화 되어 제1마이크로웨이브 주파수 캐비티(31)로 배치된 전송라인(24)과 제2마이크로웨이브 주파수 캐비티(102a, 102b)에 의해 형성된 도파관(100)과의 사이에 적어도 하나의 천이부를 갖추고, 이 천이부에는 전송라인의 개방단부(25a, 25b)를 마련해 이 개방단부에 의해 도파관 개방단부를 폐쇄하는 단락회로로부터 거리 0의 곳에서 도파관 캐비티내에 삽입된 긴 프로브를 형성하고, 덧붙여 천이부에는 임피던스 적합 시스템을 설계하고, 기판(23)은 고유전율의 재료로 구성하는 특징을 가지는 마이크로웨이브 주파수 장치(pp.1. 요약, pp.2 청구범위, 도면)"로서 기재되어 있습니다. 따라서 이 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본원발명의 특허청구범위 제1항 및 제10항은 본원발명의 상세한 설명에 기재된 종래기술과 상기 인용발명의 조합에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정됩니다.

[첨 부]

첨부1 일본공개특허공보 평6-283914호 사본 1부. 끝.

